

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-0518

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	(排名不分先后) 兴全基金、易方达、鹏华基金、中欧基金、诺安基金、嘉实基金、交银施罗德、汇添富、富国基金、华宝基金、华泰柏瑞、华安基金、华泰资产、广发基金、华商基金、万家基金、前海开源、永赢基金、国泰基金、农银汇理、招银理财、海富通、人保资产、百年保险资管、东吴基金、泰康资产、银华基金、光大保德信、国联安、财通基金、Point72、长江养老、太平资产、太平养老、友邦投资、平安基金、富达基金、中泰电子、华泰电子、国海电子、东方电子、中邮电子、国泰海通、中信建投、长江证券、国信证券、中信证券、西部证券
时间	2026年5月11日至5月18日
上市公司接待人员姓名	董事长、首席战略官 戴保家 董事、董事会秘书、副总经理 韩旻 董事、副总经理 赵锡凯
投资者关系活动主要内容介绍	问：公司成立 ASIC 相关独立子公司的定位是什么？为什么会选择这个时间成立子公司？ 答： 公司设立 ASIC 定制业务子公司的目的是将 ASIC 定制业务独立出来进行运营。通过业务分拆独立运作，能够进一步加大人才、研发、市场及其他资源的投入，实现与母公司业务高效协同互补，做大做强 ASIC 定制业务板块，更好支撑公司自研芯片产品+芯片设计服务双轮驱动的整体战略

布局。

从设立时机来看，前期定制业务及 AI 推理市场格局尚未明朗，叠加外部合规与产业环境存在不确定性，公司保持了相对稳健的投入节奏。当前行业环境已发生明显变化：一方面国内 AI 算力、端侧推理市场需求持续爆发，行业规模与落地场景已具备成熟发展基础；同时，公司评估外部合规要求趋于稳定，公司也在合规算力芯片技术布局上完成了充分的积累；另一方面，公司自研蜂窝 IoT 及智能 SoC 产品布局日趋完善，主业经营规模稳步提升、盈利能力持续改善，叠加自身已有充足项目资源积累，此时设立独立子公司，有利于集中资源投入 ASIC 定制业务，把握行业高景气发展机遇。

问：公司 2026 年第一季度 1.8 亿收入中的 NRE 收入构成是怎样的？

答：2026 年第一季度定制业务 1.8 亿收入中：约九成为 NRE 收入，主要是 2024 年下半年以来所承接的定制项目逐步进入交付验收阶段而形成的确收；剩余 10%左右为量产收入，这部分来自之前已经交付验收的定制项目，本季度收入中无新交付项目的量产收入贡献。

问：定制业务 NRE 完成交付后，转量产的周期大概是多久，量产收入规模是否会超过 NRE 收入？

答：ASIC 定制项目完成 NRE 研发交付后，后续量产导入及放量周期主要由客户自身产品规划、终端场景布局及市场推广节奏等因素决定，不同应用、不同客户的项目转化周期差异较大，公司不便做统一量化界定。

公司在前期筛选和承接定制项目时，会重点评估客户综合实力、产品定位、目标市场空间、量产规划及长期迭代潜力，优先储备量产确定性强、后续成长空间充足的优质项目。

从业务逻辑来看，客户投入 NRE 研发费用开发专用芯片，本身就具备规模化商用的诉求。项目若顺利实现市场落地与正常上量，单项目后续量产整体收入规模有望明显超过前期 NRE 收入；同时也可能存在部分项目受终端市场、行业竞争等因素影响，量产落地不及预期的情形，也属于行业正常商业规律。

问：公司定制业务未来的增长预期是怎样的？

答：公司当前定制业务在手订单储备充足，存量项目正按研发、流片、交付、验收节奏稳步推进，已经验收交付的项目若后续顺利量产，将持续为公司带来营收贡献；新订单保持持续签约节奏，且普遍采用先进工艺制程，单个项目 NRE 规模达到亿级甚至数亿级水平。当前定制业务已形成存量项目逐步交付、新增订单持续落地的良性滚动发展格局。同时，公司已成立定制业务独立子公司，将加大资源投入，做大做强相关业务，更好匹配公司整体战略布局。综合订单储备、项目结构及资源投入来看，公司对定制业务未来成长具备充足信心。

风险提示：由于当前预期距离收入实现尚有较长时间跨度，政策环境、市场情况、项目进度等客观因素可能导致动态变化，请注意投资风险，以后续公司披露信息为准。

问：公司定制业务聚焦的方向有哪些？项目量产可能性及对公司业绩的增量贡献怎样预估？

答：公司定制芯片业务重点聚焦的方向包括：1) 云端 AI，目前在手订单金额占比最高，是未来收入的主要构成，在后续量产方面具有确定性较强、量产规模较稳定的特点；2) 端侧 AI 领域，与公司现有自研业务协同性最高，在合规性方面风险最低，量产方面虽存在放量时点的不确定性，但若出现

爆款产品，会为公司带来显著的业务增量；3) 智能穿戴领域，与公司自有芯片业务高度契合，公司多个自研 IP 和技术可直接复用，量产方面考量和端侧 AI 类似，客户产品一旦形成市场爆款，可为公司带来巨大业务增量；4) RISC-V 及工业控制，公司在 RISC-V 领域已经提前布局，和产业客户展开合作，是后续业务的重要支撑方向，公司长期看好，同时工业控制/存储类现有业务也会持续推进。

问：公司定制业务子公司团队扩张计划是什么？未来是否会对外融资？是否会和大客户绑定？

答：定制业务子公司现阶段正有序扩充专业研发与业务团队，人才招聘重点聚焦研发能力扎实、行业经验丰富、价值观高度契合的核心骨干，整体团队扩张将结合在手订单体量与业务发展节奏稳步推进，坚持稳健有序扩充，不会盲目大规模激增人员。

融资方面，子公司后续有开展市场化外部融资的可能。

在股东与客户合作层面，定制子公司定位为面向各行业开放的芯片定制服务平台，服务各类有芯片定制需求的市场客户。因此公司对股东层面深度绑定单一大客户的模式会保持审慎态度，坚持市场化独立运营、多元拓展客户结构，保障业务长期健康发展的一贯原则。当然也不排除引入具备产业资源、生态协同及战略赋能价值的投资方的可能性。

问：手机 SoC 芯片面积通常较小，公司长期专注该领域，进行 ASIC 大型芯片研发是否会有难点？

答：公司从 2018 年起已经开展大型云端芯片的定制业务，截至目前已完成十余个项目的量产交付，在此领域已经具有丰富的研发经验，没有技术瓶颈。手机 SoC 和云端大型芯片开发难度的差异主要体现在设计约束条件不同：手机

SoC 需要同时兼顾面积小、功耗低、性能高的严苛要求，设计难度更高；云端大型芯片对面积、功耗的容忍度相对宽松，主要以达成既定性能指标为设计前提。

问：目前端侧 AI 兴起，有没有基于公司第二代 4G 8 核手机 SoC 的端侧定制？

答：公司已有基于第二代 4G 8 核智能 SoC 平台的智能端侧应用定制项目，目前正在设计研发阶段。

问：阿里网络作为第一大股东是否参与公司运营，目前给公司提供了哪些支持，是否有业务层面的实质帮助？

答：阿里网络目前为公司单体第一大股东，其性质为财务投资人，双方目前无业务层面的合作。

问：公司 4G 蜂窝物联网业务的整体增长情况如何？

答：2026 年第一季度，4G 蜂窝物联网业务板块的销售规模不论同比还是环比，均取得了较大幅度的增长；从目前客户的 forecast 数据来看，今年二季度比一季度有稳定增长，公司对全年出货情况较为乐观。

问：公司 5G eMBB 和印尼客户的合作情况如何？是否已经出货？预计对公司带来的增量如何？是否还有其他项目进行？

答：客户基于公司 1901 平台的 5G eMBB 产品于年初完成印尼运营商认证测试，并于年初开始规模量产；首季出货即达 50 万套，后续成长可期。

印尼项目中，公司产品在跟国际主流厂商竞争中脱颖而出，并顺利进入大规模商用，标志着公司的 5G eMBB 产品已经成熟，并具备很强的竞争力。为公司后续更多 5G 产品

	<p>进入市场打下良好的基础。</p> <p>除了印尼，基于公司 1901 的 5G 产品在多个国家进行推广，并在部分国家也已经形成突破。</p> <p>问：公司第一代 4G 8 核 SoC 的市场推广进度怎么样？今年是否有量的预估？</p> <p>答：公司第一代 4G 8 核智能 SoC 目前市场推广进度符合预期：</p> <p>1) 在智能车机方面，该芯片已经通过合作方案商天际通用于 20+品牌商的产品中，覆盖中国、东南亚、日本、印度、中东、东欧、西欧、北美、拉美等多个地区。其他方案商合作正在进行。</p> <p>2) 在智能手机及其他智能终端方面，基于该芯片平台的各类终端产品已实现全球发售（包括北美、欧洲、拉美、东南亚、中东、非洲、印度、日本等），其网络兼容性、平台稳定性已经得到充分验证。</p> <p>整体来看，公司该系列产品今年出货有望突破百万量级。</p> <p>问：公司第二代 4G 8 核 SoC 的市场推广进度怎么样？是否已经有方案做进品牌/白牌客户？</p> <p>答：公司正稳步推进该产品的市场推广与客户导入工作，目前已与多家客户开展方案交流/Design In 阶段，部分客户项目已进入立项及联合调试阶段，覆盖国内二线品牌、海外拉美/非洲主流品牌、白牌头部厂商，同时延伸至平板、AIoT 智能硬件客户。</p> <p>问：公司第一颗 5G 智能 SoC 目前的情况？是否有新一代 5G 芯片的迭代计划？</p>
--	---

	<p>答：目前首颗 5G 智能 SoC 测试进展顺利，即将开始场外测试。第二代 5G 智能 SoC 目前已经接近研发后期，预计将于今年年底或明年年初流片。具体情况请以公司后续公开披露信息为准。</p> <p>问：公司 3D DRAM 目前项目处于设计、流片、验证还是量产阶段？何时能够落地量产并产生实际营收效益？</p> <p>答：公司目前已有不止一个基于 3D DRAM 架构适配的云端算力 ASIC 定制项目正在有序推进中。相关项目预计从 2026 年第四季度起，将逐步进入交付验收阶段。</p> <p>至于项目后续何时导入量产、量产规模以及营收兑现节奏，主要由下游客户自身产品规划、市场导入及规模化出货进度决定。</p> <p>备注：需特别说明的是，本次交流活动问答回复中，所有关于未来业务发展的预期，因预测周期距当前时点尚有一定时间跨度，政策环境、市场情况、项目进度等客观因素可能存在动态变化，具体数据以当年审计数字为准，请投资者注意投资风险。</p>
附件清单 (如有)	无